

证券代码： 003031

证券简称：中瓷电子

河北中瓷电子科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

2026-005 号

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他 （请文字说明其他活动内容）	
参与单位名称及人员姓名	富国基金 王昭光 惠升基金 彭柏文 国海证券 杜先康 国海证券 张建民 上海悦众私募 余伟 中银三星人寿 杨祺 方正富邦基金 刘馨遥 盘京投资 王莉 招商通信 李哲瀚 国泰海通 周明嶝 浙商通信 林亮亮 鸿途私募 张文丰 建信养老 闫哲坤 鸿途私募 王焕振 国寿安保 孟亦佳 诚通基金 祝靖涵 景顺长城 周晋冬 国泰海通 夏凡 源峰基金 孔令鑫 长盛基金 侯智忠 泓德基金 李昕阳 西藏源乐晟资产管理 吴雨哲 九方智投 王德慧 浦银安盛基金 王晔 上海仙人掌私募基金 刘日光 国投电子 马良 中信建投 张玉龙 中邮创业基金 姚婷 中信建投 王大林 银华基金 范昭楠 华能贵诚信托 黄凯立 长盛基金 郭堃 中信证券 赵康 华泰证券 宫宇博 中银基金 王虹宇 国金基金 张洪耀 中信证券 杨昕芸 勤辰基金 江磊 中信证券 冷威 景元投资 张轶乾 博普资产 雍国铁 深圳市全景网络有限公司 郭 腾跃基金 史艺涛 洋	

	天风证券 赵子淇 真科基金 王洪祥 东方基金 梁忻 上海仙人掌私募基金 武文博 深圳市弘洛私募基金 李恩国 华能贵诚信托 张帅 长江通信 操俊茹 招商证券 廖世刚 犁得尔私募基金 陈恺睿 犁得尔私募基金 顾宇丰 趣时资产 张景乔 北京秋收私募基金 安思泽 北京秋收私募基金 李永磊 北京秋收私募基金 胡国鹏 上海启泰私募基金 王超 北京暖逸欣私募基金 刘记龙 青骊投资 石川林 大成基金 李煜 华泰资产 冯信然 新华基金 王永明 泉果基金 孙涛 平安基金 刘奇 诚通基金 董馨谣 东方财富 陈力涵 信泰人寿 齐津 东方资产 杨晓燕 国海证券 徐菲	深圳江南鸿远基金管理 息波 上海启浦投资 侯锋 上海仙人掌私募基金 姚跃 银华基金 杨丹 明溪资产 姚远 山西证券 陈玉卢 光大证券 尹会伟 光大证券 孔厚融 兴业证券 许梓豪 兴业证券 代小笛 国金基金 边广洁 众安在线财产 徐赛 拾贝投资 申宗航 胤胜资产 李美泽 诚通资本 王鸿瀚 诚通资本 赵建林 泉果基金 张家盛 碧云资本 赵心好 碧云资本 刘馨遥 长盛基金 赵万隆 鹏华基金 周书臣 中邮基金 汪显森 淡水泉（北京）投资管理有限 公司 周坤凯 运舟资本 丁俊枫 中信证券 包宇昊
时间	2026 年 9 月 16 日--9 月 17 日	
地点	河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21	
上市公司接待人员姓名	1. 中瓷电子 常务副总经理（代总经理） 梁向阳 2. 中瓷电子 副总经理、财务总监、董事会秘书 董惠 3. 中瓷电子 副总经理 孙晓明 4. 中瓷电子证券部工作人员	

投资者关系活动 主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 1.上半年电子陶瓷材料及元件业务营收大增 70.16%，是公司增长的主要引擎。请问这块业务的增长驱动力是什么？ 全球新一轮 AI 技术爆发带动算力需求激增，直接拉动了数据中心建设和升级，从而对光模块产生了爆发式需求。作为光模块封装关键材料，陶瓷外壳和基板市场需求快速增长，特别是氮化铝薄膜基板作为低成本非气密封装方案的关键封装材料呈现供不应求的情况。受益于 AI 算力、高端光通信行业高景气，光模块用陶瓷外壳、陶瓷基板订单大幅放量，产能利用率维持高位，是公司当期业绩增长的核心支撑板块之一。 2. 上半年电子陶瓷板块在产线自动化升级、良率提升、降本增效方面取得了哪些成效，后续还有哪些工作计划？ 公司上半年，电子陶瓷板块持续推进产线自动化、数字化改造升级，生产过程管控能力进一步增强；通过精益生产持续落地见效，主要产品成品良率得到稳步改善。同时，公司长期以来一直积极推动降本增效工作，坚持从原材料成本管理、全过程成本管控、产品生产良率提升、生产流程优化提效等各个维度达到成本节约、效能提升等目的，积极提升公司业绩。感谢您的关心。同时公司从供应链管理、生产精益管理、费用管控等多维度落实降本增效举措，取得阶段性成果，进一步提升公司盈利水平。 3. 公司上半年实现营业收入 22.11 亿元，同比增长 54.76%；归母净利润 4.03 亿元，同比增长 41.22%。利润增速明显低于收入增速，请问这一主要原因是什么？ 一是受产品结构调整影响，高增长的电子陶瓷产品较其他板块产品毛利率略低；二是黄金、有色金属等材料价格上涨对陶瓷外壳形成成本压力。 4. 下半年利润率趋势如何展望？ 公司目前订单饱满，产能利用率一直维持在较高水平，规模效应将进一步显现。同时，公司持续关注多元技术路线，加强研
---------------------------	---

	发投入，强化前瞻布局与技术储备。 5. 公司新增“高精密电子陶瓷生产线扩建项目”的必要性与前景如何？ 该项目涉及的氮化铝薄厚膜基板、通信器件用电子陶瓷外壳、精密陶瓷零部件产品是国家重点支持的民品产业之一。项目建设符合国家、河北省、石家庄市及中国电子科技集团公司发展规划和产业政策要求，建设机构完备，资金落实，建设条件满足石家庄市鹿泉区政府要求，相关手续齐全、配套条件具备。同时，高精密电子陶瓷生产线扩建项目涉及的产品均采用公司自主知识产权的材料、设计、工艺等核心技术，利用原有成熟多层陶瓷制备工艺，进行生产线扩建。相关产品已经在国内多家大客户处验证通过，并批量供货。中瓷电子在电子陶瓷外壳产品技术方面国内领先，相关产品性能与国际大公司同类产品相当，广泛应用于光通信、无线通信、轨道交通、低碳供热制冷、汽车电子、半导体设备、低空经济等领域。 6. 公司在产业链整合方面的布局，如何发挥协同效应？ 公司已通过资产重组，形成电子陶瓷+第三代半导体全产业链布局，覆盖材料、芯片、封测、模块全环节，协同效应显著。同时，公司收购雄安太芯 100%股权，雄安太芯的高频芯片业务可以很大程度上拓展公司当前射频芯片的工作频率和应用领域，扩充公司射频产品线，巩固公司在化合物射频芯片行业的优势地位，进一步增强上市公司半导体领域科技创新与产业协同。 7. 公司氮化镓射频业务当前国内市场竞争格局如何，博威相较同行核心竞争优势体现在哪里？ 子公司博威公司在氮化镓通信基站射频芯片与器件以及微波点对点通信射频芯片与器件领域，突破了 IC 设计、封测制造、可靠性和质量控制等环节的一系列关键核心技术，拥有自主知识产权，实现产品系列化开发和产业化转化，市场占有率国内领先，产品指标和质量达到国际先进水平。
--	---

8. 子公司博威公司下半年以及中长期发展规划是什么，是否会进一步扩充产能？

公司积极推进新一代移动通信射频芯片与器件关键技术突破和产品研发与产业化工作，在氮化镓通信基站射频芯片与器件以及微波点对点通信射频芯片与器件领域，持续推进新一代产品系列化开发和产业化转化工作；同时，围绕 6G 通信、卫星通信射频芯片与器件，低空经济、固态射频源等领域，储备关键技术，稳步推进产品开发和产业化布局工作。

9. 子公司国联万众公司 6 寸改 8 英寸碳化硅晶圆产线升级通线之后，当前客户导入、产能爬坡进度如何？

公司 8 英寸 SiC 工艺产线完成升级通线，完成第五代平面栅 SiC MOSFET 工艺开发，实现关键指标突破，多款 8 英寸车规芯片已经产出并交付头部车企开展试用验证。客户导入层面，多款 8 英寸芯片正在推进头部车企、充电桩、工业电源客户的可靠性验证，同步开展 PCN 变更相关工作；封测平台第一阶段已完成建设，碳化硅高压功率模块产线通线。产能爬坡方面，公司当前正加快新增设备入场调试、工艺迭代优化，同步完善 KGD、晶圆级老化等配套能力，逐步完成良率提升与产能释放，稳步向目标产能爬坡。

10. 子公司国联万众公司未来在第三代半导体板块的中长期战略规划？

公司聚焦第三代半导体碳化硅、氮化镓两大主线，打造国内领先的“芯片- 模块”一体化产业平台。碳化硅重点深耕新能源汽车、光伏储能、工业、电网等市场；氮化镓射频面向 5G- A、卫星互联网、低空安防、反无人机等领域拓展；积极推进募集资金项目落地，完善 8 英寸晶圆、封测平台产能建设，同时通过对外合作、本地化布局完善产业生态。

11. 子公司雄安太芯核心产品太赫兹芯片主要应用在哪些场景，现阶段商业化落地、订单情况如何？

	子公司雄安太芯核心产品太赫兹芯片主要应用在仪器仪表测试测量、高速通信、人体安检等场景。现阶段商业化落地、订单情况良好,上半年指标完成较好,上半年实现营业收入6660.76万元,净利润1817.75万元。 12. 子公司雄安太芯下半年及中长期经营发展目标,未来研发重点方向? 子公司雄安太芯将持续在测试测量、高速通信、人体安检等领域深耕,与行业龙头企业深度合作。未来研发重点方向是测试测量用核心芯片产品、高速通信用核心芯片产品。 风险提示: 二级市场股价受行业、宏观经济环境、投资者价值判断及资本市场整体状况等多方面因素共同影响,请投资者谨慎判断,注意投资风险。
附件清单(如有)	无
日期	2026-9-17